

## インタビュー

ヤマハロボティクス株  
代表取締役社長

### 中村 亮介 氏



（東京都港区）は、ヤマハロボティクス（株）（東京都港区）は、ヤマハロボティクス（株）ハ発動機グループにおいて、半導体後工程装置などを扱う企業が統合するかたちで7月にヤマハロボティクスが誕生した。

ヤマハロボティクス（株）（東京都港区）は、ヤマハロボティクス（株）ハ発動機グループにおいて、半導体後工程装置などを扱う企業が統合するかたちで7月にヤマハロボティクスが誕生した。

中村 ヤマハ発動機では、ボンディング装置などを扱う（株）新川、モールディング装置や金型など手がけるアピックヤマ

スとしての取り組みをお聞かせ下さい。

中村 新技術の開発スピードを向上させるとともに、ものづくり力の強化にも取り組んでいる。また、販売面での連携、

ハロボティクスホールディングス（株）、新川、アピックヤマダ、PFAの4社が1つになるかたちで7月にヤマハロボティクスが誕生した。

——開発について。  
中村 コア領域向けでは、高速・高精度ワイヤーボンディング装置「UTC-RZ1」と、マルチプロセスモードイング装置「MS-R series」を投入した。

広いユニバーサルな技術があり、その技術をベースにしながら変化が激しい半導体業界のニーズに素早く対応するため、共創活動にも力を入れていきたいと考えて



ユールを生産することも検討している。こうした取り組みを含めて、25～27年の設備投資額は前3年（23～25年）の2・2倍を計画している。

——今後の方向性をお聞かせ下さい。

中村 ヤマハ発動機グループは、世界の人々に新たな感動と豊かな生活を提供する「感動創造企業」を目指しており、そのなかでヤマハロボティクスは「ロボティクスで感動をひらく」をミッションとして掲げている。ヤマハ発動機ブランド、半導体、ロボティクスという3つのキーワードを掛け合わせることで、成長を期待できる非常に面白い会社になると考へており、今後は半導体後工程のトータルソリューション企業としての存在感をさらに高めていくことを目指す。

——生産面での施策は。

中村 ボンディング装

置などを製造する西東京事業所（東京都武蔵村山市）にて、24年に生産能力を従来比約4倍に拡大

（24年12月期）は、AI

ダ（株）、電子デバイス業界向けの製造装置を開拓する（株）PFAをグループ会社として抱え、そして3社を統括する完全子会社としてヤマハロボティクスホールディングス（株）を運営していた。こうしたなか、シナジーの最大化を図り、半導体後工程のトータルソリューション企業として飛躍するために、ヤマ

ハロボティクス（株）（東京都港区）は、生産性と精度が高く、狭キャップ成形などを実現している。

MS-Rは、生産性と精度が高く、狭キャップ成形などを実現している。

成長領域では、パネルレベルパッケージへの対応技術をお持ちの方で、当社の取り組みとともに進めていただけた方がいればぜひお声がけいただきたい。

——製品の需要動向について。

中村 2024年度

（聞き手・編集長 稲葉雅巳／副編集長 浮島哲志）

## 後工程ソリューションを総合提供

25～27年の設備投資は2.2倍を計画

おり、先端半導体分野においてコア領域を固めつつ、成長領域のニーズを的確に捉えていくことで、27年度に売上高500億円を目指す。

大し、25年にはさらに生産能力を上げていく。また、海外でもタイにある生産拠点において、従来はワイヤーボンディング装置のみを生産していたが、ダイボンディング装置やフリップチップボンディング装置の一部モジュールを生産できる体制を24年に構築した。さら

に、タイの拠点でモールディング装置の一部モジ

テー（株）との取り組みを進めています。一方で、成長領域では、パネルレベルパッケージへの対応技術をお持ちの方で、当社の取り組みとともに進めていただけた方がいればぜひお声がけいただきたい。

——生産面での施策は。

中村 ボンディング装置などを製造する西東京事業所（東京都武蔵村山市）にて、24年に生産能力を従来比約4倍に拡大

（24年12月期）は、AI

ダ（株）、電子デバイス業界向けの製造装置を開拓する（株）PFAをグループ会社として抱え、そして3社を統括する完全子会社としてヤマハロボティクス（株）（東京都港区）は、生産性と精度が高く、狭キャップ成形などを実現している。

成長領域では、パネルレベルパッケージへの対応技術をお持ちの方で、当社の取り組みとともに進めていただけた方がいればぜひお声がけいただきたい。